

**FAX – ANTWORT**

**030 | 63 92 17 29**

**OpTecBB**



Hiermit melde ich mich verbindlich für das Fokusseminar  
>> Photonik Packaging aus Berlin << an.

Anmeldungen sind bis zum 31.05.2011 per Fax oder per  
E-Mail an optecbb@optecbb.de möglich.

Infos: OpTecBB, Telefon: 030 / 6392 1720  
E-Mail: optecbb@optecbb.de  
<http://optecbb.de/lang/de/aktuelles/aktuelle-meldungen.php>

Ort: WISTA-MANAGEMENT GMBH  
Rudower Chausse 17  
Kleiner Clubraum (Im Rahmen der BEL 2)  
12489 Berlin

Die Veranstaltung ist kostenfrei.

\_\_\_\_\_  
Titel, Vorname, Name

\_\_\_\_\_  
Firma / Institution

\_\_\_\_\_  
Straße

\_\_\_\_\_  
PLZ / Ort

\_\_\_\_\_  
Telefon

\_\_\_\_\_  
Telefax

\_\_\_\_\_  
E-Mail

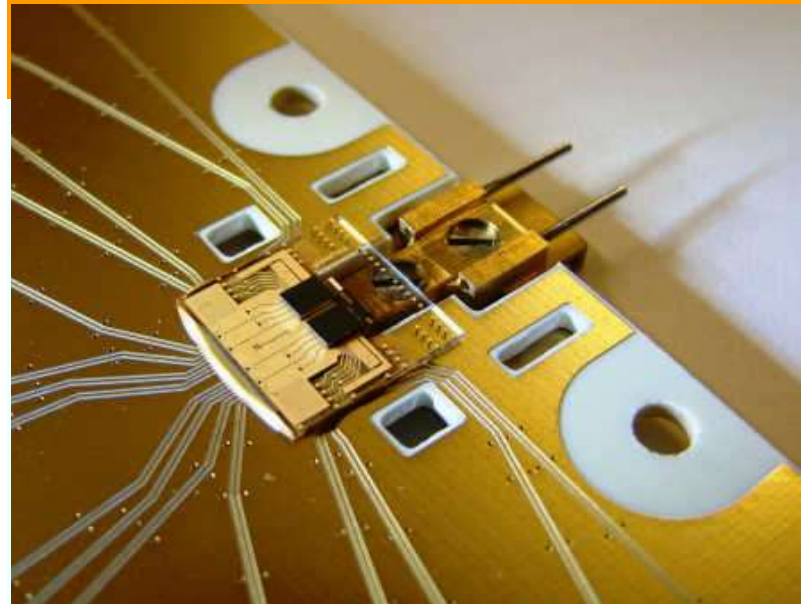
\_\_\_\_\_  
Datum / Unterschrift



Das Fokusseminar findet im Rahmen der  
Fach- und Publikumsmesse BEL 2 statt.  
<http://bel2.net/>

## **Schwerpunkt Photonik für Kommunikation und Sensorik**

### **Fokusseminar >>Photonik Packaging aus Berlin<<**



**Mittwoch, 08. Juni 2011**

09:30 – 12:15 Uhr

WISTA-MANAGEMENT GMBH  
Rudower Chausse 17  
Kleiner Clubraum (Im Rahmen der BEL 2)  
12489 Berlin



# PROGRAMM:

Beim „Photonic Packaging“ werden mit den Technologien der Aufbau- und Verbindungstechnik optoelektronische Bauelemente in Produkte umgesetzt. In solchen optoelektronischen Modulen sind Kantenemitter, VCSEL oder LEDs, Detektoren aber auch passive Elemente wie Linsen, optische Fasern, Filter und Polarisatoren integriert. Hierfür sind speziell an die Photonik angepasste Technologien, Simulations- und Entwurfsmethoden notwendig. Wesentlich ist die Entwicklung von zuverlässigen Prozessen, die geeignet sind für die Serienfertigung. Manuelle Aufbau- und Verbindungstechniken müssen durch standardisierte Methoden und Verfahren, geeignet für eine Automatisierung, abgelöst werden. Weiterhin:

- kostengünstige Fertigungstechnik für Module der Daten- und Telekommunikation (optische Netze)
- neue Komponenten für die schnelle optische Datenübertragung in Hochleistungsrechnern
- optimierte Integration von optischen Strahlquellen zur Erhöhung der Lebensdauer
- Steigerung der Lichtausbeute bei High Brightness LEDs für die ressourcensparende Beleuchtung
- optische Sensoren für die Bereiche Medizin-, Umwelt- und Sicherheitstechnik

Derzeit müssen für die Aufbau- und Verbindungstechnik bis zu 90% der Gesamtkosten aufgewendet werden, das Interesse ist daher groß, Potenziale für mögliche Kostenreduktionen zu identifizieren und die Zuverlässigkeit und Fähigkeit zur Massenproduktion zu verbessern. Unternehmen aus Berlin sind seit vielen Jahren auf diesem Gebiet tätig und präsentieren ihr Potenzial und spezielle Lösungen auf dem Fokuseminar.

- 09:35 **Photonic Packaging aus Berlin**  
Dr. Henning Schröder, Fraunhofer IZM
- 10:00 **Photonic Packaging for High-Speed Components for Advanced Communication Systems**  
Dr. Carsten Schramm, Benjamin Völker, u²t Photonics AG
- 10:20 **Komponenten und Packaging auf dem Wege von 40 zu 100 Gbit/s**  
Dr. Torsten Mehlhorn, COGO Optronics GmbH
- 10:45 **Serienfertigung optischer Mikrobauteile mit waferbasierter Produktion**  
Jörg.-R. Kropp, Ezconn Europe GmbH
- 11:10 **Dünnglasbasierte Systemintegration auf Modul- und Boardlevel**  
Dr. Henning Schröder, Fraunhofer IZM
- 11:35 **Kundenspezifische AVT von optoelektronischen Modulen und Faserkopplung**  
Carsten Schramm, OECA GmbH
- 12:00 **Kompatibilität optischer Steckverbinder nach IEC 61755 (Grade A)**  
Axel Thiel, FOC GmbH
- 12:00 **Schlußwort**  
Dr. Henning Schröder, Fraunhofer IZM

## **Sprecher:**

Dr. Henning Schröder  
Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration (IZM); System Integration and Interconnection Technologies  
Telefon: 030 / 46403-277  
E-Mail: Henning.Schroeder@izm.fraunhofer.de

## **Organisation und Kontakt:**

Dr. Weidner  
OpTecBB  
Telefon: 030 / 6392 1720  
E-Mail: optecbb@optecbb.de